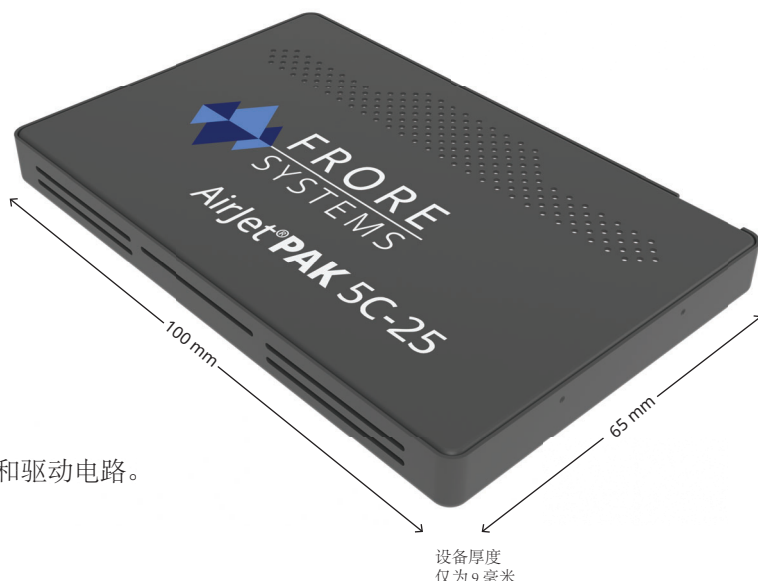




AirJet® PAK 5C-25

助力 NVIDIA Jetson Orin NX/AGX Orin, 释放 AI 性能。

- 完全独立的即插即用式散热解决方案，包含多枚 AirJet 芯片和驱动电路。
- 可直接集成于 NVIDIA Jetson Orin NX/AGX Orin 模块上。
- 自主运行。
- 薄型、静音、无振动、防尘且防水。
- 支持算力峰值高达 100 TOPS，散热净值 25W。



散热是现代计算领域的瓶颈，但散热技术却依然停留在百年之前的水平。随着 AI 技术的发展，对高效散热的需求日益迫切。预计到 2030 年，边缘 AI 的需求将增长 300% 以上，这一趋势并不会很快改变。

AirJet PAK，全球首创的首款边缘 AI 固态主动散热方案，采用革命性的 AirJet 芯片。AirJet PAK 5C-25 是一款独立式主动散热模块。

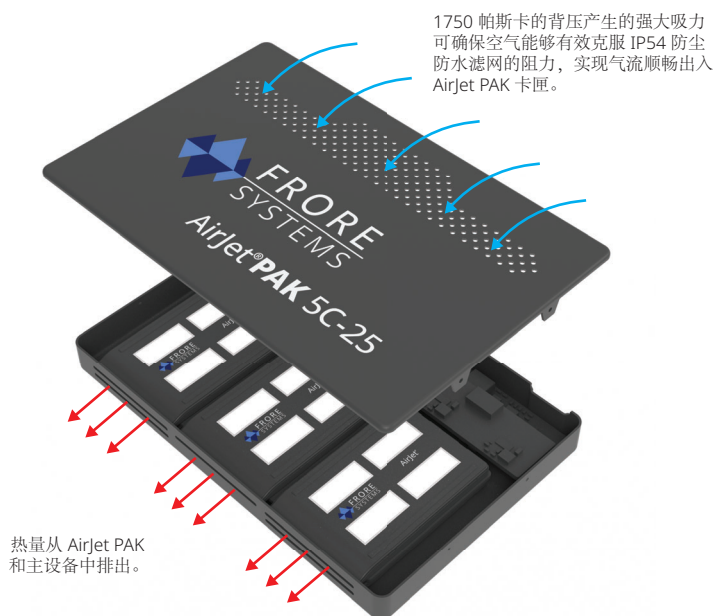
卓越的散热能力 - AirJet PAK 5C-25 在噪音值仅有 29 dBA 的静音下，可从 NVIDIA Jetson TOPS 平台中高效散热 25W，同时自身功耗仅为 6.5W。当集成到温度为 80°C 的计算平台，紧凑的边缘 AI 设备中时，其性能超越传统风扇。

释放 AI 潜能——AirJet PAK 5C-25 仅 9 毫米厚，
专为 NVIDIA Jetson Orin NX 和 AGX Orin
模块量身定制。这种超薄设计为制造商提供了全新的
可能性，以满足消费者对更高性能、更紧凑、更静音、
无振动、防尘和防水设备的日益增长的需求。

AirJet PAK	NVIDIA Jetson	TOPS	Power
AirJet PAK 5C-25	Orin NX 16GB	100	25 W
2x AirJet PAK 5C-25	AGX Orin 32GB	200	50 W

AirJet PAK 5C-25 内置 5 枚 AirJet 芯片，这是全球首创的首款固态主动散热芯片。

指标	AirJet® PAK 5C-25
总净散热量 (@ 80°C 散热器温度, 25°C 环境温度)	25 W
峰值噪音 (距离 50cm)	29 dBA
峰值功耗	6.5 W
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 x 长 x 厚)	100 x 65 x 9 mm
重量	100 g



AirJet® PAK 5C-25

持续性能及可靠性

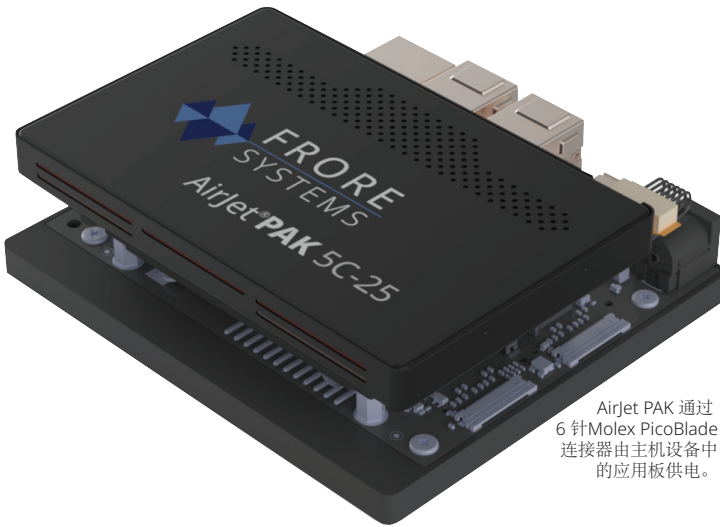
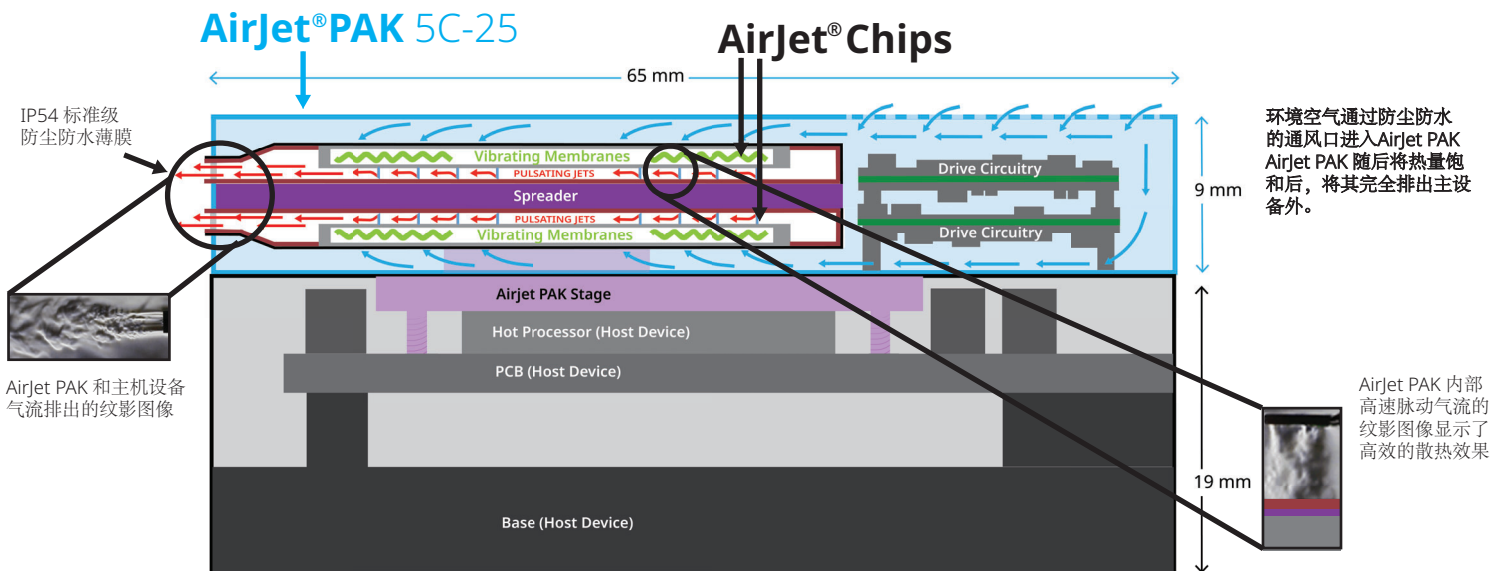
AirJet PAK 产生1750帕斯卡的背压，确保即使在通风口被IP54防尘防水滤网覆盖的情况下，依然能够实现有效的空气流动。这与AirJet PAK的智能自清洁功能相结合，实现了可靠性的最大化，并确保AirJet PAK的持续散热性能，从而使防尘主设备保持高性能。

AirJet PAK 可以自主运行，利用创新的温感技术独立感知周围温度，从而优化其性能，在不依赖主机设备温度传感器的情况下，最大化散热效果。

AirJet PAK 所需的仅仅是来自主设备的电源，就能够显著提升处理器的性能。

在当今的设备中，决定性能的往往是散热解决方案的能力，而不仅仅是处理器的复杂性。得益于 AirJet PAK 5C-25，紧凑型边缘 AI 电子设备现在能够兑现尖端 AI 技术的承诺，实现更多。

主机设备内部 AirJet PAK 模块的剖面图



AirJet PAK 通过 6 针 Molex PicoBlade 连接器由主机设备中的应用板供电。

AirJet PAK，优化 NVIDIA Jetson Orin NX 和 AGX Orin 模块性能

NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 基准测试数据

